

## 第11回複合材型加工研究会セミナー 講演プログラム

日時 平成29年11月22日(水) 13時00分～16時30分

場所 キャンパスイノベーションセンター東京 多目的室2

〒108-0023 東京都港区芝浦3-3-6

(JR 山手線・京浜東北線 田町駅から徒歩1分,都営地下鉄浅草線・三田線 三田駅から徒歩5分)

主催 複合材型加工研究会

協賛 東京抜型工業会

関東甲信越静紙器段ボール箱工業連合会

12:30～12:55 受付

13:00 開催の挨拶

山口 大志郎君 (片山抜型製作所)

1. 実践講座 リンテック株式会社 金子 智君 13:05-14:15

「粘着フィルムの押抜き加工における技術課題」

粘弾性材料である粘着フィルム特有の切断特性に関する研究内容を紹介いたします。

2. 実践講座 無名総研 会長 吉田雅彦君他 14:15-15:25

「新世代の抜型のご紹介」

これまでとは違う抜型の解説および事例を紹介いたします。

3. 基礎講座 長岡技術科学大学 千葉玲央君, 山本哲也君 15:30-16:10

感熱紙の突切り特性の観察と板紙の傾斜溝罫線加工について

突切り切断特性をデジタル化する研究, 罫線加工の品質調査の活動について紹介します。

4. 基礎講座 長岡技術科学大学 永澤 茂君 16:10-16:50

板紙の切断および曲げに関する基本原理の説明と問題解決方法を簡単にご説明します。

16:50 閉会の挨拶

永澤 茂君 (長岡技術科学大学)

お願い アンケート回答にご協力願います。

\*会場の都合上、先着順に50名様までとなります。また各社2名様までとさせていただきます。

申し込み方法

Eメールにてお申込みください。

申し込み先(株)片山抜型製作所 山口 大志郎 daiyama@diemex.com